



全球半导体行业周报

半导体指数八连跌，台积电与 ASML 上调全年预期，资本开支预测继续上修

发布主体：百思特变革研究院半导体智库 | 期次日期：2026-10-18 | 覆盖窗口：2026-10-12 至 2026-10-18 | 截至美东时间 10 月 18 日 21:00（北京时间 10 月 19 日 09:00）

本期总判断

本周半导体股与基本面数据反向运行。费城半导体指数连跌 8 个交易日、周跌 11.41%，同周台积电、ASML 业绩高于预期并上调全年展望。

一、股价回调集中在存储、设备与网络互连。SK 海力士周跌 24.33%、三星电子跌 17.75%，KOSPI 10 月 15 日单日跌 7.57%。应用材料周跌 19.28%，Ciena 跌 26.02%。

二、台积电四季度指引中值环比增长约 14%。三季度营收 467.2 亿美元，高于一致预期约 2.9%；四季度指引 523 亿—543 亿美元，全年美元营收增速上调至约 44%。

三、ASML 称 2027—2028 年供给不足。三季度每股收益 12.95 欧元，高于一致预期 21%；2026 年营收指引 440 亿—450 亿欧元。

四、资本开支预测上修。TrendForce 预计九大云厂商 2027 年资本开支超过 1.5 万亿美元；SEMI 预计 2026 年 300mm 设备支出 1,490 亿美元、增长 31%。

五、中国公布技术出口目录修订草案。14nm 及以下芯片设计技术拟纳入出口管理，征求意见至 11 月 15 日；美国联邦公报本周无新的管制文件。

资本市场：纳斯达克综合指数周跌 4.48%，科创 50 周跌 6.77%，粤芯半导体上市首日收涨 223.06%。

宏观约束：美国 9 月 CPI 同比 3.7%，高于 3.6% 的市场预期；美债 10 年期收益率 10 月 15 日为 5.10%，周内下行 14 个基点。

需要跟踪的关键变量：10 月 21 日 Lam Research 财报；10 月 28—29 日 SK 海力士、三星与 Intel 财报；11 月 10 日稀土管制暂停期到期。

目录

本周概览.....3

一、本周要点.....7

二、重大事件及其影响.....8

三、行业景气与资本市场.....9

四、存储周期与装备制造链.....10

五、政策、贸易与供应链安全.....11

六、重点企业动态.....11

七、中国半导体产业链.....12

八、行业会议与人物观点.....13

九、趋势判断.....13

十、主要风险与下周关注事项.....14

十一、管理观察与行动建议.....15

数据来源与口径.....16

阅读导引：企业决策层建议优先阅读本周要点、重大事件及其影响、趋势判断与管理观察；制造、存储与设备企业建议重点阅读存储周期与装备制造链、重点企业动态；政策研究者与资本市场研究者建议重点阅读行业景气与资本市场、政策贸易与供应链安全、主要风险与下周关注事项。

本周概览

关键指标

全球半导体月销售额（8月，SIA） 1,597 亿美元 同比 +144.3%，环比 +8.0% 三个月移动平均；9月数据尚未发布	300mm 晶圆厂设备支出（2026 年预测，SEMI） 1,490 亿美元 同比 +31% 10月13日发布；2029 年预测 2,270 亿美元	韩国半导体出口（10月1—10日） 121 亿美元 同比 +170.9% 同期总出口 261 亿美元
费城半导体指数（10月16日） 11,137.29 周 -11.41% 连跌 8 个交易日；10月9日为 12,572.4	科创 50 指数（10月16日） 1,358.65 周 -6.77% 10月14日单日 -3.29%	DDR5 16Gb 现货均价（10月16日） 60.600 美元 较 10月9日 +2.9% DDR4 16Gb 为 83.660 美元，周内持平
台积电四季度营收指引 523 亿—543 亿美元 中值环比 +14% 三季度 467.2 亿美元，高于一致预期约 2.9%	九大云厂商资本开支（2026 年预测，TrendForce） 9,570 亿美元 同比 +106% 2027 年预测超过 1.5 万亿美元	美债 10 年期收益率（10月15日） 5.10% 周 -14 个基点 10月9日为 5.24%；FRED 尚未更新 10月16日数据

一周大事记（2026 年 10 月 12 日至 10 月 18 日）

10月12日 周一	■ 韩国关税厅公布 10 月 1—10 日出口 261 亿美元，半导体出口 121 亿美元、同比增长 170.9% ■ Broadcom 首席执行官陈福阳在新加坡谈人工智能投资预期（据 Babypips 报道） ■ Micron 跌 3.88%，费城半导体指数跌 2.67% 至 12,236.8 ■ OCP 全球峰会在圣何塞开幕，NVIDIA 向 OCP 贡献 Vera Rubin 机架设计与 800V 直流参考架构，单机架功率最高 250 千瓦 ■ AMD 发布 Helion 开放机架蓝图，纯 CPU 机架最高 32,768 个 EPYC 核心 ■ Marvell 发布六通道 CXL 3.2 内存扩展器 Structera X，2027 年一季度送样 ■ Microsoft 发布 Maia 300 推理芯片，称每兆瓦 token 数较领先 GPU 系统多 40% ■ 科创 50 收 1,426.72，跌 2.10%
---------------------------------	---

10月13日

周二

- SEMI 预计 2026 年全球 300mm 晶圆厂设备支出 1,490 亿美元、同比增长 31%，2029 年达 2,270 亿美元
- SEMICON West 2026 在旧金山开幕
- 应用材料公布 2030 年非 GAAP 毛利率 54%、营业利润率 40% 的目标，称先进逻辑与 DRAM 稼动率 100%
- 粤芯半导体在创业板上市，收盘 38.80 元，较发行价 12.01 元上涨 223.06%，总市值 1,116.76 亿元
- 特拉华州陪审团认定 Arm 违反与高通的架构许可协议，判赔 2 美元名义损害
- SK 海力士单日跌约 10.09%
- 长鑫存储披露 4F² DRAM 设计进展，称存储单元面积缩小约 33%（据 Babypips 报道）
- 微导纳米公布定增预案，拟募资不超过 49.44 亿元

10月14日

周三

- ASML 公布三季度净销售额 116.62 亿欧元、每股收益 12.95 欧元
- ASML 四季度指引 142 亿—152 亿欧元，称 2027—2028 年供给不足
- TrendForce 预计九大云厂商 2026 年资本开支 9,570 亿美元、2027 年超过 1.5 万亿美元
- 美国公布 9 月 CPI 同比 3.7%、核心同比 2.6%，均高于市场预期 0.1 个百分点
- 中国 9 月集成电路出口 449.51 亿美元、同比增长 136%，数量同比增长 1%
- 羲禾科技通过科创板上市委审议
- 湾芯展在深圳开幕，展商 1,000 余家
- SEDEX 2026 在首尔开幕，三星与 SK 海力士展出 HBM4E
- 科创 50 跌 3.29% 至 1,380.26，半导体板块单日净流出超过 62 亿元

10月15日

周四

- 台积电公布三季度营收 467.2 亿美元、毛利率 66.4%
- 台积电四季度营收指引 523 亿—543 亿美元，全年增速上调至约 44%
- 台积电资本开支维持 600 亿—640 亿美元
- KOSPI 跌 7.57%，SK 海力士跌 11.06%，日经 225 跌 4.90%，Advantest 跌约 15%，铠侠跌约 12%
- 据 Reuters 报道 SK 海力士寻求美方批准向大连工厂安装设备
- 拓荆科技公告拟以约 25 亿元收购三家公司并配套募资 18.2 亿元
- 北方华创拟以 4.05 亿元收购混合键合设备企业诺合键维
- 海光信息预告前三季度净利润 27.1 亿—29.8 亿元、同比增长 38.16%—51.93%
- 江波龙预告前三季度归母净利润 140 亿—149 亿元
- 季丰电子创业板上会获得通过
- 美债 10 年期收益率 5.10%

10月16日 周五	- 费城半导体指数跌 3.83% 至 11,137.29，连跌 8 个交易日，周跌 11.41%，30 只成分股当日全部下跌 - 中国公布《禁止出口限制出口技术目录》修订草案，涉及人工智能大模型与芯片设计技术 - 台湾提出拟把人工智能服务器与先进半导体纳入对大陆出口管理清单 - NVIDIA RTX Spark 笔记本上市，起价 2,399 美元 - KOSPI 反弹 2.05% 至 5,668.05 - 台湾加权指数收 47,111.26，台积电台股收 2,420 新台币 - 科创 50 收 1,358.65，周跌 6.77% - 恒生科技指数收 4,108.24
10月17日 周六	24/7 Wall St. 统计费城半导体指数八连跌为 2008 年以来最长（Bloomberg 标题称 2006 年以来最长） - 据 21 世纪经济报道，本周 A 股半导体板块成交额超过 1,800 亿元，江波龙三季度单季利润环比下降
10月18日 周日	- 据首尔经济日报报道，三星将委托台积电以 3nm 工艺代工 NVIDIA 定制 HBM 的基础裸片 - NVIDIA 要求三家存储厂的定制 HBM 统一采用该基础裸片 - 据 Semafor 报道中国仍在评估人工智能模型与芯片出口管理细则

一周图表

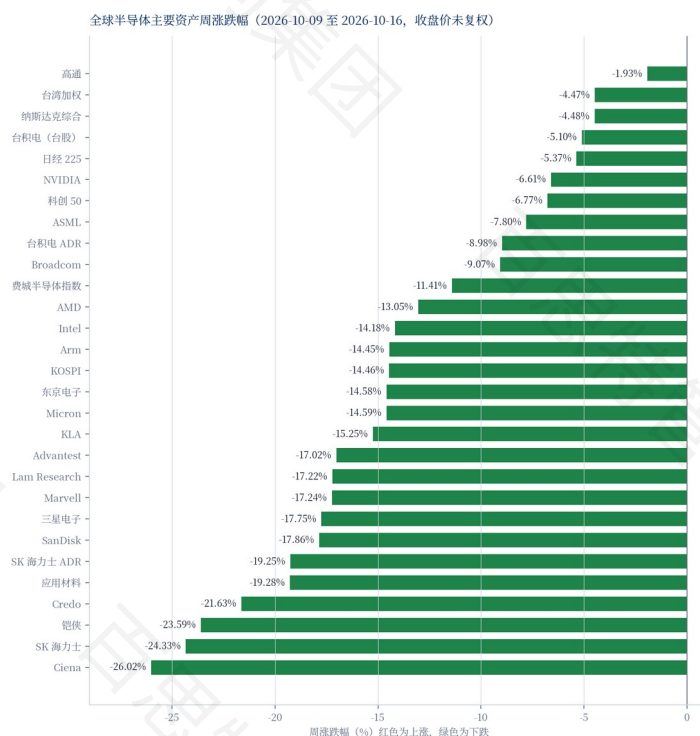


图1 全球半导体主要资产周涨跌幅（2026-10-09至2026-10-16，收盘价未复权；三星电子、SK 海力士、KOSPI 与台湾标的以10月8日收盘为起点；数据来源：stockanalysis.com、investing.com、FRED、新华财经）

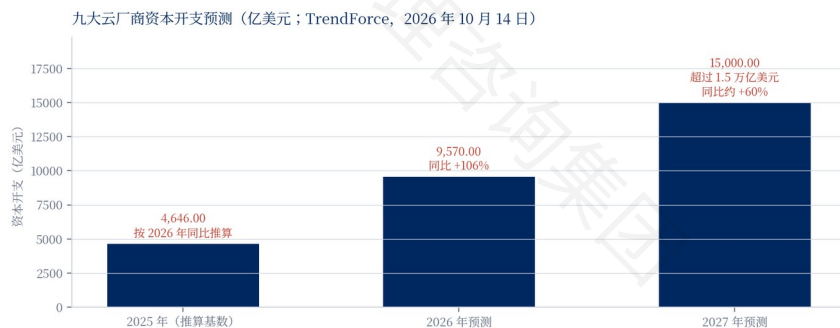


图2 九大云厂商资本开支预测（数据来源：TrendForce，2026年10月14日发布；2025年为按2026年同比增速推算的基数）

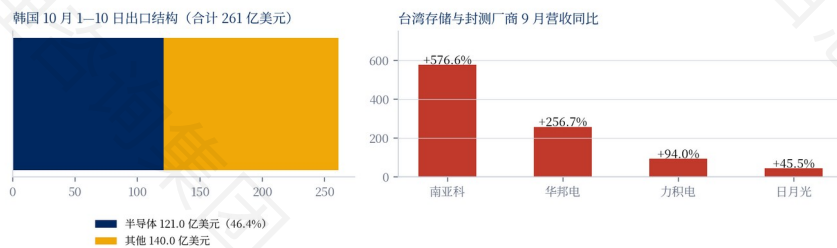


图3 韩国10月1—10日出口结构与台湾存储及封测厂商9月营收同比（数据来源：韩国关税厅经 Yonhap 报道；各公司月营收公告经 TechNews 报道）

一、本周要点

本周半导体股连跌 8 个交易日，同周晶圆代工与光刻龙头上调全年展望，资本开支预测再次上修。

- 费城半导体指数周跌 11.41%，连跌 8 个交易日。10 月 16 日收 11,137.29，当日 30 只成分股全部下跌；同期纳斯达克综合指数周跌 4.48%。
- 韩国存储股录得 2008 年以来最大周跌幅。SK 海力士周跌 24.33%，三星电子周跌 17.75%，KOSPI 10 月 15 日单日跌 7.57%。
- 台积电三季度营收 467.2 亿美元，高于一致预期约 2.9%。四季度营收指引 523 亿—543 亿美元，中值环比增长约 14%；2026 年美元营收增速上调至约 44%。
- 台积电 2nm 占晶圆营收比重由二季度的 3% 升至 8%。3nm 占 33%，高性能计算平台占 68%，2027 年 N2 家族产能将增加一倍以上。
- ASML 三季度每股收益 12.95 欧元，高于一致预期 21%。四季度营收指引 142 亿—152 亿欧元，公司称 2027—2028 年供给无法完全满足需求。
- TrendForce 预计九大云厂商 2027 年资本开支超过 1.5 万亿美元。2026 年预测 9,570 亿美元，同比增长 106%；2027 年增速预测由 50% 上调至约 60%。
- SEMI 预计 2026 年 300mm 晶圆厂设备支出 1,490 亿美元，同比增长 31%。2029 年预测 2,270 亿美元 2026—2029 年每年两位数增长。
- 韩国 10 月 1—10 日半导体出口 121 亿美元，同比增长 170.9%。占同期总出口 261 亿美元的 46.4%。
- 中国 9 月集成电路出口 449.51 亿美元，同比增长 136%。出口数量同比仅增长 1%，增长来自单价上升。
- 中国公布技术出口目录修订草案。14nm 及以下或 2.5D/3D 堆叠的芯片设计技术拟纳入出口管理，征求意见至 11 月 15 日。

二、重大事件及其影响

本周 9 项重大事件中，财报与产能类 5 项、资本市场类 2 项、政策类 2 项；两项政策均未进入生效阶段。

事件	环节	对产业的影响	来源与可信度
台积电三季度营收 467.2 亿美元，四季度指引 523 亿—543 亿美元（10 月 15 日）	晶圆代工	2026 年营收增速上调至约 44%；资本开支维持 600 亿—640 亿美元，2027 年卖方预测 830 亿—900 亿美元	公司新闻稿；高
ASML 三季度每股收益 12.95 欧元，称 2027—2028 年供给不足（10 月 14 日）	光刻设备	2026 年营收约 440 亿—450 亿欧元；存储占系统销售 46%；EUV 交期影响晶圆厂建设节奏	公司财报；高
费城半导体指数周跌 11.41%（10 月 9—16 日）	资本市场	美股半导体市值单周减少超过 1 万亿美元；设备股周跌 15%—19%	交易数据；中高
韩国存储双雄周跌 17.75%、24.33%	存储	股价下跌先于基本面变化；10 月 28—29 日两家财报给出 HBM 出货口径	交易数据；中高
TrendForce 上调云厂商资本开支预测（10 月 14 日）	需求端	2027 年人工智能服务器营收约 9,200 亿美元，占服务器市场约 81%	TrendForce；高
SEMI 预计 2026 年 300mm 设备支出 1,490 亿美元（10 月 13 日）	设备	2026 年新建晶圆厂 20 座、2027 年 18 座；2027 年晶圆厂建设支出 633 亿美元	SEMI；高
长鑫存储披露 4F ² DRAM 进展	存储	Counterpoint 称其二季度 DRAM 营收份额 10%，上年同期 4%；市场开始交易 2028 年后的供给	据媒体报道；中
中国技术出口目录修订草案（10 月 16 日）	政策	芯片设计技术对外授权与合作研发需评估；征求意见至 11 月 15 日	据 AP 报道；中高
粤芯半导体上市首日收涨 223.06%（10 月 13 日）	中国制造	总市值 1,116.76 亿元，为创业板首家晶圆制造企业	交易数据；中高

三、行业景气与资本市场

本周新发布的高频数据全部为正增长，半导体指数周跌幅为纳斯达克综合指数的 2.5 倍。

韩国 10 月 1—10 日半导体出口 121 亿美元，同比增长 170.9%，占总出口的 46.4%。中国 9 月集成电路出口 449.51 亿美元，同比增长 136%，1—9 月集成电路进口同比增长 56.6%。台湾存储厂 9 月营收同比增长 94%—577%，南亚科增长 576.6%，华邦电增长 256.7%，力积电增长 93.95%。日月光投控 9 月营收 881 30 亿新台币，同比增长 45.5%，创单月新高。DDR5 16Gb 现货均价 10 月 16 日为 60.600 美元，较 10 月 9 日上涨 2.9%。

指标	最新值	同比或周变化	期间与说明
全球半导体销售额（SIA）	1,597 亿美元	同比 +144.3%	8 月；9 月数据尚未发布
韩国半导体出口	121 亿美元	同比 +170.9%	10 月 1—10 日
中国集成电路出口	449.51 亿美元	同比 +136%	9 月；数量同比 +1%
日本制半导体设备销售额	5,979 亿日元	同比 +47.4%	8 月；9 月数据尚未发布
台积电营收	467.2 亿美元	同比 +41.2%	三季度，美元口径
DDR5 16Gb 现货均价	60.600 美元	周 +2.9%	10 月 16 日
美国 CPI	3.7%	预期 3.6%	9 月；10 月 14 日发布
美债 10 年期收益率	5.10%	周 -14 个基点	10 月 15 日

费城半导体指数 10 月 16 日收 11,137.29，周跌 11.41%，距 6 月 22 日峰值回撤 23.9%。设备、存储与网络互连个股周跌 15%—26%，NVIDIA 周跌 6.61%，高通周跌 1.93%。科创 50 周跌 6.77% 至 1,358.65，上证指数周跌 2.56% 至 3,716.28。台湾加权指数周跌 4.47%，台积电台股收 2,420 新台币。亚洲市场跌幅高于美股：KOSPI 周跌 14.46%，日经 225 周跌 5.37%，东京电子、Advantest、铠侠周跌 14.58%—23.59%。

标的	10 月 9 日	10 月 16 日	周涨跌	说明
费城半导体指数	12,572.4	11,137.29	-11.41%	连跌 8 个交易日
NVIDIA	229.28	214.13	-6.61%	OCP 贡献 Vera Rubin 机架设计
台积电 ADR	453.31	412.61	-8.98%	四季度指引中值环比 +14%
ASML	1,780.34	1,641.52	-7.80%	每股收益高于预期 21%

标的	10月9日	10月16日	周涨跌	说明
Micron	1,029.00	878.84	-14.59%	存储股集体下跌
应用材料	507.03	409.29	-19.28%	八连跌累计约 21%
Lam Research	318.84	263.94	-17.22%	10月21日财报
Ciena	449.77	332.73	-26.02%	网络互连跌幅最大
SK 海力士（韩元）	1,681,000（10月8日）	1,272,000	-24.33%	10月15日单日 -11.06%
三星电子（韩元）	262,000（10月8日）	215,500	-17.75%	外资持股比例 45.98%
KOSPI	6,625.93（10月8日）	5,668.05	-14.46%	10月15日单日 -7.57%
科创 50 指数	1,457.27	1,358.65	-6.77%	10月14日单日 -3.29%

存储板块本周跌幅最大，对应 10 月 13 日长鑫存储的 4F² DRAM 进展。设备板块周跌 7.80%—19.28%，同周设备支出预测上调。网络互连板块周跌 16%—26%，为上周涨幅最大的方向。计算芯片跌幅最小，下游算力租赁企业 CoreWeave 与 Nebius 周跌约 25%。

四、存储周期与装备制造链

存储与设备两个环节本周的经营口径最强，股价跌幅也最大。

存储环节的现货价与股价反向。DDR5 16Gb 现货均价周涨 2.9%，DDR4 16Gb 持平于 83.660 美元。TrendForce 9 月 30 日预测四季度常规 DRAM 合约价环比上涨 10%—15%，NAND 上涨 15%—20%，本周没有下调。Counterpoint 数据显示，长鑫存储 2026 年二季度 DRAM 营收份额 10%，三星、SK 海力士、Micron 分别为 38%、25%、24%。长鑫存储称 4F² 设计使存储单元面积缩小约 33%，计划年底推出服务器 DDR5 模块。三星与 SK 海力士在首尔 SEDEX 展会展出 HBM4E，三星同场展出 400 层以上 V10 NAND。据首尔经济日报报道，NVIDIA 要求三家存储厂的定制 HBM 统一采用台积电 3nm 基础裸片。

设备环节的需求口径本周全部上调。SEMI 预计 2026 年 300mm 晶圆厂设备支出 1,490 亿美元，2029 年 2,270 亿美元。晶圆厂建设支出 2027 年 633 亿美元，同比增长 33%。ASML 三季度出货新机 113 台，2026

年存储系统收入增长约 75%。公司称已公布的 2027 年 30% 扩产不足以满足 2028 年需求，部分客户希望预订 2029—2030 年设备。应用材料在 SEMICON West 称先进逻辑与 DRAM 稼动率 100%，限制来自洁净室。应用材料股价八连跌累计约 21%，Lam Research 周跌 17.22%，KLA 周跌 15.25%。

五、政策、贸易与供应链安全

本周美国没有新的出口管理或关税文件，中国与台湾各提出一项出口管理方案，两项均未生效。

10 月 16 日，中国公布《禁止出口限制出口技术目录》修订草案。草案共 40 项，人工智能 23 项、光伏 12 项、生物医药 5 项（据 The Next Web 报道）。芯片设计技术的门槛为 14nm 及以下或 2.5D/3D 堆叠，大模型门槛为 2 万亿参数以上。开源代码与已发表研究豁免，征求意见截止 11 月 15 日。同日台湾提出拟把人工智能服务器与先进半导体纳入对大陆出口管理清单，需修订相关法律，尚无时间表。

美国联邦公报 10 月 12—18 日以"semiconductor"检索共 7 份文件，均为专利程序与企业生产授权类文件。中美贸易休战已延至 2027 年 1 月 10 日。2025 年 10 月扩围的稀土出口管理暂停期于 11 月 10 日到期，本周没有延期公告。镓、锗、锑对美出口限制的暂停期于 11 月 27 日到期。美国先进制造投资税收抵免要求 2026 年 12 月 31 日前开工，本周未见延期立法进展。

六、重点企业动态

本周 8 家重点企业发布财报、产品或产能信息，美股与韩股主要标的周跌幅全部超过 1.9%。

企业	本周动态	关键数字	来源
台积电	三季度财报；全年增速上调至约 44%；亚利桑那二厂 2027 年三季度量产	毛利率 66.4%	公司新闻稿
ASML	三季度财报；评估 2028 年追加产能	116.62 亿欧元	公司财报
NVIDIA	向 OCP 贡献 Vera Rubin 机架与 800V 直流参考架构	机架最高 250 千瓦	公司新闻稿
AMD	Helion 开放机架蓝图	纯 CPU 机架 32,768 核	公司新闻稿
Microsoft	Maia 300 推理芯片，2027 年起多吉瓦部署	每兆瓦 token 数 +40% (厂商口径)	公司新闻稿

企业	本周动态	关键数字	来源
Marvell	六通道 CXL 3.2 内存扩展器	最高 6TB DDR5	公司新闻稿
应用材料	2030 年财务目标	非 GAAP 毛利率 54%	公司会议纪要
高通与 Arm	陪审团认定 Arm 违反架构许可协议	名义损害 2 美元	高通声明

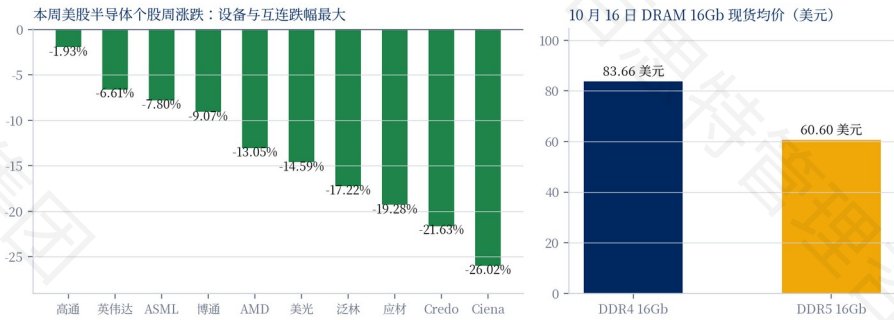


图 4 本周美股半导体个股周涨跌与 DRAM 16Gb 现货均价（数据来源：stockanalysis.com；DRAMeXchange，10 月 16 日）

台积电三季度 3nm 与 2nm 合计占晶圆营收 41%，7nm 及以下合计 79%。公司计划 A14 于 2027 年风险试产、2028 年量产。台南新增三座 3nm 工厂，日本二厂改用 3nm 并于 2028 年量产。ASML 三季度毛利率 57.5%，较二季度上升 3.5 个百分点。

七、中国半导体产业链

中国半导体本周经营数据与融资活动向上，科创 50 周跌 6.77%。

粤芯半导体 10 月 13 日在创业板上市，收盘 38.80 元，较发行价 12.01 元上涨 223.06%，总市值 1,116.76 亿元。海光信息预告前三季度净利润 27.1 亿—29.8 亿元，同比增长 38.16%—51.93%。沐曦股份预告前三季度净利润 5.87 亿—7.17 亿元，上年同期亏损 3.46 亿元。羲禾科技 10 月 14 日通过科创板上市委审议，8 月在手订单 45.51 亿元。长江存储科创板申请处于问询阶段，拟募资 330 亿元。

设备企业本周以并购扩充产品线。北方华创以 4.05 亿元收购混合键合设备企业诺合键维 100% 股权。拓荆科技拟以约 25 亿元收购三家公司，配套募资 18.2 亿元。微导纳米拟定增募资不超过 49.44 亿元。湾芯展 10 月 14—16 日在深圳举行，展商 1,000 余家，同比增长 66%。

领域	本周事实	数字	关注要点
设计	海光、沐曦预告前三季度业绩	海光净利润同比 +38.16%—	10 月下旬其他设计企业三

领域	本周事实	数字	关注要点
		51.93%	季报
制造	粤芯上市	首日 +223.06%	上市后一个月股价
存储	长鑫 4F ² DRAM；长江存储问询中	长鑫二季度份额 10%	长江存储上会时间
设备	北方华创、拓荆并购；微导定增	合计约 96.7 亿元	并购标的在先进封装中的订单
资本市场	科创 50 周跌 6.77%	10 月 14 日单日 -3.29%	半导体 ETF 份额变化

八、行业会议与人物观点

本周四个行业会议发布了供电、存储、互连与设备企业财务目标的量化指标。

OCP 全球峰会 10 月 12—15 日在圣何塞举行，NVIDIA、AMD、Intel、Marvell、Microsoft 发布机架、芯片与互连规格。NVIDIA 称 800V 直流架构可减少铜用量约 45%。SEMICON West 10 月 13—15 日在旧金山举行，预计参会 35,000 人。湾芯展与 SEDEX 同周在深圳与首尔举行。

台积电董事长魏哲家 10 月 15 日在电话会上称，供需缺口"still quite big"。Broadcom 首席执行官陈福阳 10 月 12 日在新加坡称，融资可得性对行业的约束大于存储短缺（据 Babypips 报道）。应用材料首席执行官 Gary Dickerson 10 月 13 日称，公司已上调晶圆厂设备展望，限制来自洁净室。国际货币基金组织 10 月 13 日在《世界经济展望》中预计，2026 年台湾经济增长 10.7%、韩国增长 3.3%（据 IANS 报道）。

九、趋势判断

本期给出 6 条判断，存储股估值调整先于基本面，2027 年资本开支上修延续。

- 存储利润增速在 2026 年四季度至 2027 年一季度见顶，股价已提前反映。前提条件：四季度 DRAM 合约价上涨 10%—15% 兑现。反向情形：若 10 月 28 日 SK 海力士给出 2027 年一季度价格继续上涨的口径，存储股本周跌幅在 11 月内收复一半以上。
- 台积电 2027 年资本开支超过 800 亿美元。前提条件：2nm 产能翻倍与海外工厂按计划量产。反向情形：若 2027 年 1 月指引低于 750 亿美元，下调先进制程设备需求判断。

- 2027 年 EUV 设备交付成为晶圆厂扩产的主要约束。前提条件：ASML 2027 年扩产 30%，客户 EUV 层数增加。反向情形：若 ASML 2027 年 1 月未公布追加产能且交期未延长，约束转回洁净室。
- 设备股与订单口径的反向在 11 月中旬前收敛。前提条件：Lam Research、KLA、东京电子给出 2027 年增长口径。反向情形：若三家中两家表示 2027 年持平，设备股本周跌幅对应真实需求变化。
- 人工智能算力采购在 2027 年向云厂商与定制芯片集中。前提条件：Maia 300 等定制芯片 2027 年部署。反向情形：若四季度非云厂商公布单笔 100 亿美元以上的芯片采购融资，判断修正。
- HBM 基础裸片在 2027 年转向台积电 3nm。前提条件：相关报道获公司确认。反向情形：若三星 10 月 29 日财报确认标准 HBM4E 继续使用自有 4nm，外包仅限定制产品。

十、主要风险与下周关注事项

主要风险由供给短缺转向融资成本与 2028 年后的存储供给。

风险	本周事实	判断标准
融资成本	美债 10 年期 5.10%；算力租赁企业周跌约 25%	10 年期收益率升破 5.5%
存储远期供给	长鑫二季度 DRAM 份额 10%	长鑫服务器 DDR5 在年底前通过主要客户认证
估值回撤	费城半导体指数距 6 月峰值回撤 23.9%	回撤超过 30%
出口管理	中国技术出口目录草案；台湾拟议方案	草案在 11 月 15 日后正式发布且范围不变
政策到期	11 月 10 日稀土、11 月 27 日镓锗锑暂停期	两项均无延期公告

日期	事件	关注要点	需要修正本期判断的情形
10 月 21 日	韩国 10 月 1—20 日出口	半导体出口同比	同比低于 150%
10 月 21 日	Lam Research 财报	存储订单占比与 2027 年展望	表示 2027 年持平
10 月下旬	日本 9 月设备销售	同比增速	同比低于 35%
10 月 28 日	SK 海力士三季报	HBM 出货与 2027 年签约比例	HBM 营收环比下降

日期	事件	关注要点	需要修正本期判断的情形
10 月 29 日	三星电子完整财报、Intel 三季报	存储部门利润率；代工外部客户	存储部门利润率低于 75%
10 月 30 日	东京电子、铠侠财报	设备订单；NAND 价格	NAND 价格指引低于 +15%
11 月 10 日	稀土出口管理暂停期到期	延期安排	到期未延期
11 月 15 日	技术出口目录草案征求意见截止	正式文本范围	芯片设计门槛由 14nm 放宽

十一、管理观察与行动建议

芯片设计与系统企业应在 2026 年四季度锁定 2027 年 2nm 与 CoWoS 产能。台积电称供需缺口仍大，2027 年 N2 产能翻倍仍需提前排队。采用定制 HBM 的企业需同时与存储厂和台积电协商产能。

制造、存储与封测企业应在 10 月下旬财报中分别披露 2027 年 HBM 已签约比例与常规 DRAM 价格口径。长鑫存储份额已达 10%，2028 年以后的价格情形应写入长期合同条款。日月光 9 月营收同比增长 45.5%，封测企业可利用当前稼动率谈判一年以上的产能协议。

设备与材料企业应按客户厂房完工时间排产。SEMI 预计 2027 年晶圆厂建设支出增长 33%，应用材料称限制来自洁净室。ASML 称 2027—2028 年供给不足，零部件供应商可据此争取长期采购协议。

中国产业链企业应在 11 月 15 日前梳理受技术出口目录草案影响的海外授权与联合研发项目。北方华创、拓荆本周通过并购进入混合键合与沉积新领域，其他设备企业可评估以并购补齐先进封装设备。粤芯首日涨 223.06%，有上市计划的特色工艺企业可利用当前窗口推进申报。

政策研究者应把重点放在 11 月 10 日与 11 月 27 日两个暂停期到期，以及中国与台湾两项出口管理方案的产品范围与生效日期。

上市公司与资本市场研究者应在估值模型中加入两项情形：10 年期美债收益率升破 5.5%，以及 2028 年 D RAM 价格同比下降。本周两家龙头财报超预期，股价仍周跌 7.80%—8.98%。

数据来源与口径

涨跌幅为 10 月 9 日至 10 月 16 日收盘价，未复权，不换汇；韩国与台湾股票以 10 月 8 日收盘为起点。数据来源包括台积电与 ASML 财报、SEMI、SIA、TrendForce、DRAMeXchange 与 FRED。韩国出口数据经 Yonhap 报道，行情取自 stockanalysis.com 与 investing.com。媒体转述信息已注明出处，单一来源信息未进入本报告判断。

本报告由百思特变革研究院半导体智库基于公开信息编制，数据截至 2026-10-18。报告内容仅供行业研究参考，不构成任何投资建议，不代表任何政府机构或监管部门的立场；所涉政策信息均来自公开发布的法规、公告与新闻报道；引用请注明出处。